ORGANIZACIÓN MUNDIAL

WT/MIN(96)/16

13 de diciembre de 1996

DEL COMERCIO

(96-5438)

CONFERENCIA MINISTERIAL

Singapur, 9-13 de diciembre de 1996

DECLARACIÓN MINISTERIAL SOBRE EL COMERCIO DE PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

SINGAPUR, 13 DE DICIEMBRE DE 1996

Los Ministros.

En representación de los siguientes Miembros de la Organización Mundial del Comercio ("OMC") y Estados o territorios aduaneros distintos en proceso de adhesión a la OMC, que han llegado a un acuerdo en Singapur sobre la expansión del comercio mundial de productos de tecnología de la información, y que representan un porcentaje bastante superior al 80 por ciento del comercio mundial de esos productos ("partes"):

Australia Japón
Canadá Noruega
Comunidades Europeas Singapur
Corea Suiza¹

Estados Unidos Territorio Aduanero Hong Kong Distinto de Taiwán, Indonesia Penghu, Kinmen y Matsu

Islandia Turquía

Considerando la función clave que desempeña el comercio de productos de tecnología de la información en el desarrollo de las industrias de la información y en la expansión dinámica de la economía mundial,

Reconociendo los objetivos de elevación de los niveles de vida y expansión de la producción y el comercio de mercancías,

Deseosos de conseguir la máxima libertad del comercio mundial de productos de tecnología de la información,

Deseosos de fomentar el desarrollo tecnológico continuo de la industria de la tecnología de la información en todo el mundo,

¹En nombre de la unión aduanera de Suiza y Liechtenstein.

Conscientes de la contribución positiva que hace la tecnología de la información al crecimiento económico y al bienestar mundiales,

Habiendo acordado llevar a efecto los resultados de estas negociaciones que implican concesiones adicionales a las incluidas en las Listas anexas al Protocolo de Marrakech anexo al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994,

Reconociendo que los resultados de estas negociaciones implican también algunas concesiones ofrecidas en negociaciones conducentes al establecimiento de Listas anexas al Protocolo de Marrakech,

Declaran lo siguiente:

- 1. El régimen de comercio de cada parte deberá evolucionar de manera que aumenten las oportunidades de acceso a los mercados para los productos de tecnología de la información.
- 2. De conformidad con las modalidades establecidas en el Anexo de la presente Declaración, cada parte consolidará y eliminará los derechos de aduana y los demás derechos o cargas de cualquier clase, en el sentido del párrafo 1 b) del artículo II del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, con respecto a los siguientes productos:
 - a) todos los productos clasificados (o clasificables) en las partidas del Sistema Armonizado de 1996 ("SA") enumeradas en el Apéndice A del Anexo de la presente Declaración; y
 - b) todos los productos especificados en el Apéndice B del Anexo de la presente Declaración, estén o no incluidos en el Apéndice A;

mediante reducciones iguales de los tipos de los derechos de aduana a partir de 1997 y hasta el año 2000, reconociendo que, en limitadas circunstancias, podría ser necesario ampliar el escalonamiento de las reducciones y, antes de la aplicación, los productos comprendidos.

- 3. Los Ministros manifiestan su satisfacción por el gran número de productos comprendidos que figuran en los Apéndices del Anexo de la presente Declaración. Encomiendan a sus respectivos representantes que hagan esfuerzos de buena fe para finalizar las conversaciones técnicas plurilaterales que se celebrarán en Ginebra sobre la base de esas modalidades y que completen esa tarea no más tarde del 31 de enero de 1997, con el fin de conseguir que la presente Declaración sea aplicada por el mayor número posible de participantes.
- 4. Los Ministros invitan a los Ministros de los demás Miembros de la OMC y de los Estados o territorios aduaneros distintos en proceso de adhesión a la OMC a que impartan instrucciones análogas a sus respectivos representantes, con el fin de que puedan tomar parte en las conversaciones técnicas a que se hace referencia en el párrafo 3 *supra* y participar plenamente en la expansión del comercio mundial de productos de tecnología de la información.

Anexo: Modalidades y productos comprendidos

Apéndice A: Lista de partidas del SA

Apéndice B: Lista de productos

ANEXO

Modalidades y productos comprendidos

Todo Miembro de la Organización Mundial del Comercio, o Estado o territorio aduanero distinto en proceso de adhesión a la OMC, podrá participar en la expansión del comercio mundial de productos de tecnología de la información de conformidad con las modalidades siguientes:

- 1. Cada participante incorporará las medidas descritas en el párrafo 2 de la Declaración a su lista anexa al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y además, a nivel de línea arancelaria de su arancel o a nivel de 6 dígitos del Sistema Armonizado de 1996 ("SA"), a su arancel oficial o a cualquier otra versión publicada del arancel de aduanas, si fuera esa otra la utilizada comúnmente por los importadores y los exportadores. Cada uno de los participantes que no sea Miembro de la OMC aplicará estas medidas de manera autónoma, en espera de la culminación de su adhesión a la OMC, y las incorporará a su lista sobre acceso a los mercados para las mercancías, anexa al Acuerdo sobre la OMC.
- 2. A estos efectos, cada participante proporcionará a los demás participantes lo antes posible, y en todo caso el 1º de marzo de 1997 a más tardar, un documento que contenga a) los pormenores sobre cómo preverá el trato arancelario adecuado en su lista de concesiones anexa al Acuerdo sobre la OMC, y b) una lista de las partidas detalladas del SA a las que correspondan los productos especificados en el Apéndice B. Estos documentos se examinarán y se aprobarán por consenso y el proceso de examen se terminará el 1º de abril de 1997 a más tardar. En cuanto haya terminado este proceso de examen de cualquiera de esos documentos, ese documento se presentará como modificación de la Lista del participante de que se trate, de conformidad con la Decisión de 26 de marzo de 1980 sobre Procedimientos para la modificación o rectificación de las listas de concesiones arancelarias (IBDD 27S/25).
 - a) Las concesiones que debe proponer cada participante como modificaciones de su Lista consolidarán y eliminarán, de la forma que a continuación se indica, todos los derechos de aduana y los demás derechos o cargas de cualquier clase aplicados a los productos de tecnología de la información:
 - i) la eliminación de dichos derechos de aduana se llevará a cabo mediante reducciones en tramos iguales de los tipos, a no ser que los participantes acuerden lo contrario. Salvo acuerdo en contrario de los participantes, cada participante consolidará a más tardar todos los aranceles aplicados a los productos enumerados en los Apéndices el 1º de julio de 1997 y hará efectiva a más tardar la primera de esas reducciones de los tipos el 1º de julio de 1997, la segunda el 1º de enero de 1998 y la tercera el 1º de enero de 1999, y la eliminación de los derechos de aduana quedará completada el 1º de enero del año 2000 a más tardar. Los participantes acuerdan alentar la eliminación autónoma de los derechos de aduana antes de las fechas indicadas. En cada fase, el tipo reducido deberá redondearse al primer decimal; y

- ii) la eliminación de los demás derechos y cargas de cualquier clase citados, en el sentido del párrafo 1 b) del artículo II del Acuerdo General, quedará completada el 1º de julio de 1997, a no ser que en el documento facilitado por el participante a los demás participantes para su examen se indique lo contrario.
- b) Las modificaciones de su Lista que debe proponer un participante para llevar a cabo la consolidación y eliminación de los derechos de aduana aplicados a los productos de tecnología de la información tendrán ese resultado:
 - i) en el caso de las partidas del SA que se indican en el Apéndice A, mediante la creación, cuando proceda, de subdivisiones en la Lista de ese participante a nivel de línea arancelaria de su arancel nacional; y
 - ii) en el caso de los productos especificados en el Apéndice B, mediante la adición a la Lista de ese participante de un anexo en el que estarán incluidos todos los productos del Apéndice B, en el que han de especificarse las partidas detalladas del SA correspondientes a dichos productos a nivel de línea arancelaria de su arancel nacional o de 6 dígitos del SA.

Cada participante modificará inmediatamente su arancel nacional de aduanas para recoger en él las modificaciones que haya propuesto, tan pronto como éstas hayan comenzado a surtir efecto.

- 3. Los participantes se reunirán periódicamente bajo los auspicios del Consejo del Comercio de Mercancías a fin de examinar los productos comprendidos que se especifican en los Apéndices, con miras a acordar por consenso si, a la luz de la evolución de la tecnología, la experiencia en la aplicación de las concesiones arancelarias o los cambios de la nomenclatura del SA, deberán modificarse los Apéndices para incorporar productos adicionales, y a fin de celebrar consultas sobre los obstáculos no arancelarios al comercio de productos de tecnología de la información. Dichas consultas no afectarán a los derechos y obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre la OMC.
- 4. Los participantes se reunirán tan pronto como sea factible pero en todo caso no más tarde del 1º de abril de 1997 para examinar la situación de las aceptaciones recibidas y evaluar las conclusiones que deban extraerse. Los participantes pondrán en aplicación las medidas previstas en la presente Declaración a condición de que para entonces hayan notificado su aceptación participantes que representen aproximadamente el 90 por ciento del comercio mundial² de productos de tecnología de la información, y a condición de que se haya acordado el escalonamiento a satisfacción de los participantes. Para determinar si se han de poner en aplicación las medidas previstas en la Declaración, en el caso de que el porcentaje del comercio mundial representado por los participantes sea algo inferior al 90 por ciento del comercio mundial de productos de tecnología de la información los participantes podrán tener en cuenta el grado de participación de los Estados o territorios aduaneros distintos que

²Este porcentaje será calculado por la Secretaría de la OMC sobre la base de los datos más recientes de que se disponga en el momento de la reunión.

representen para ellos el volumen sustancial de su propio comercio de dichos productos. En esa reunión los participantes comprobarán si se han cumplido estos criterios.

- 5. Los participantes se reunirán cuantas veces sea necesario y en todo caso el 30 de septiembre de 1997 a más tardar para examinar las discrepancias que puedan existir entre ellos en lo que respecta a la clasificación de los productos de tecnología de la información, comenzando por los productos especificados en el Apéndice B. Los participantes se fijan el objetivo común de establecer, en su caso, una clasificación común para esos productos dentro de la nomenclatura actual del SA, tomando en consideración las interpretaciones y decisiones del Consejo de Cooperación Aduanera (conocido también como Organización Mundial de Aduanas u "OMA"). En caso de que persista una discrepancia en cuanto a la clasificación, los participantes examinarán la posibilidad de hacer una propuesta conjunta a la OMA con respecto a la actualización de la nomenclatura existente del SA o a la solución de la discrepancia en la interpretación de la nomenclatura del SA.
- 6. Los participantes entienden que el artículo XXIII del Acuerdo General será aplicable a la anulación o menoscabo de ventajas resultantes directa o indirectamente para un Miembro de la OMC de la aplicación de la presente Declaración como consecuencia de la aplicación de cualquier medida por otro Miembro de la OMC participante, esté o no dicha medida en conflicto con las disposiciones del Acuerdo General.
- 7. Cada participante examinará con comprensión cua lquier solicitud de celebración de consultas que formule otro participante con respecto a los compromisos enunciados *supra* Dichas consultas se entenderán sin perjuicio de los derechos y obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre la OMC.
- 8. Los participantes, actuando bajo los auspicios del Consejo del Comercio de Mercancías, informarán de las presentes modalidades a los demás Miembros de la OMC y a los Estados o territorios aduaneros distintos en proceso de adhesión a la OMC y entablarán consultas con miras a facilitar su participación en la expansión del comercio de productos de tecnología de la información sobre la base de la presente Declaración.
- 9. En las presentes modalidades se entenderá por "participante" todo Miembro de la OMC, o todo Estado o territorio aduanero distinto en proceso de adhesión a la OMC, que el 1º de marzo de 1997 a más tardar haya proporcionado el documento descrito en el párrafo 2.
- 10. El presente Anexo estará abierto a la aceptación de todos los Miembros de la OMC y de cualquier Estado o territorio aduanero distinto en proceso de adhesión a la OMC. Las aceptaciones se notificarán por escrito al Director General, quien las comunicará a todos los participantes.

El Anexo tiene dos Apéndices.

En el Apéndice A se enumeran las partidas del SA o las partes de las mismas que quedarán comprendidas.

En el Apéndice B se enumeran los productos específicos que quedarán comprendidos en un Acuerdo sobre Tecnología de la Información, cualquiera que sea la partida del SA en que estén clasificados.

Apéndice A, sección 1

96	SA	Designación del SA
	3818	Elementos químicos impurificados para uso en electrónica, en discos, plaquitas o formas análogas; compuestos químicos impurificados para uso en electrónica
	8469 11	Máquinas para tratamiento de textos
	8470	Calculadoras y máquinas de bolsillo registradoras, reproductoras y visualizadoras de datos, con función de cálculo; máquinas de contabilidad; máquinas de franquear, expedir boletos (tiques) y máquinas similares, con dispositivo de cálculo; cajas registradoras
	8470 10	Calculadoras electrónicas que funcionen sin fuente de energía exterior y máquinas de bolsillo registradoras, reproductoras y visualizadoras de datos, con función de cálculo
	8470 21	Las demás calculadoras electrónicas con dispositivo de impresión
	8470 29	Las demás
	8470 30	Las demás calculadoras
	8470 40	Máquinas de contabilidad
	8470 50	Cajas registradoras
	8470 90	Las demás
	8471	Máquinas automáticas para tratamiento de información y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de información sobre soportes en forma codificada y máquinas para tratamiento de esta información, no expresadas ni comprendidas en otras partidas
	8471 10	Máquinas automáticas para tratamiento de información, analógicas o híbridas
	8471 30	Máquinas automáticas para tratamiento de información portátiles y digitales, de peso inferior o igual a 10 kg, que comprendan, por lo menos, una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador
	8471 41	Las demás máquinas automáticas para tratamiento de información digitales, que lleven bajo una envuelta (gabinete) común, por lo menos, una unidad central de proceso, una unidad de entrada y una de salida, estén o no combinadas
	8471 49	Las demás máquinas automáticas para tratamiento de información digitales presentadas en forma de sistemas
	8471 50	Unidades de tratamiento digitales, excepto las de las subpartidas 8471 41 y 8471 49, aunque lleven bajo la misma envuelta (gabinete) uno o dos tipos de unidades siguientes: unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida

96	SA		Designación del SA
	8471	60	Unidades de entrada o de salida, aunque lleven unidades de memoria bajo la misma envuelta (gabinete)
	8471	70	Unidades de memoria, incluidas las unidades de memoria centrales, las unidades de memoria de disco ópticas, las unidades de memoria de disco duro y las unidades de memoria de cinta
Ï	8471	80	Las demás unidades de máquinas automáticas para tratamiento de información
	8471	90	Las demás
ex	8472	90	Cajeros automáticos
	8473	21	Partes y accesorios de máquinas de la partida 8470 de calculadoras electrónicas de las subpartidas 8470 10, 8470 21 y 8470 29
	8473	29	Partes y accesorios de máquinas de la partida 8470 que no sean las calculadoras electrónicas de las subpartidas 8470 10, 8470 21 y 8470 29
	8473	30	Partes y accesorios de máquinas de la partida 8471
	8473	50	Partes y accesorios que puedan utilizarse indistintamente con máquinas o aparatos de dos o más de las partidas 8469 a 8472
ex	8504	40	Convertidores estáticos destinados a máquinas automáticas para tratamiento de información y sus unidades, y aparatos de telecomunicación
ex	8504	50	Las demás bobinas de reactancia y de autoinducción para fuentes de alimentación de máquinas automáticas para tratamiento de información y sus unidades, y aparatos de telecomunicación
	8517		Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incluidos los teléfonos de abonado de auricular (combinado con micrófono) inalámbrico y los apartados para sistemas de telecomunicación por corriente portadora o para sistemas de telecomunicación numéricos (digitales); videófonos
	8517	11	Teléfonos de abonado de auricular (combinado con micrófono) inalámbrico
Ī	8517	19	Los demás teléfonos de abonado y videófonos
	8517	21	Telefax
Ī	8517	22	Teleimpresores
	8517	30	Aparatos de conmutación para telefonía o telegrafía
	8517	50	Los demás aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación numérica (digital)
Ī	8517	80	Los demás aparatos, incluidos los interfonos
	8517	90	Partes de aparatos de la partida 85.17
ex	8518	10	Micrófonos de una gama de frecuencias comprendida entre 300 Hz y 3,4 KHz, con un diámetro igual o inferior a 10 mm y una altura igual o inferior a 3 mm, para uso en telecomunicaciones
ex	8518	30	Auriculares de teléfono
ex	8518	29	Altavoces, sin sus cajas, con una gama de frecuencias comprendida entre 300 Hz y 3,4 KHz, con un diámetro igual o inferior a 50 mm, para uso en telecomunicaciones

0.6	SA Designación del SA		Designación del SA
96			
			Contestadores telefónicos
	8523	11	Cintas magnéticas de anchura inferior o igual a 4 mm
	8523	12	Cintas magnéticas de anchura superior a 4 mm pero inferior o igual a 6,5 mm
	8523	13	Cintas magnéticas de anchura superior a 6,5 mm
	8523	20	Discos magnéticos
	8523	30	Tarjetas con una tira magnética incorporada
	8523	90	Los demás
	8524	31	Discos para sistemas de lectura por rayos láser para reproducir fenómenos distintos del sonido o la imagen
	8524	32	Discos para sistemas de lectura por rayos láser para reproducir únicamente sonido
ex	8524	39	Los demás:
			- para reproducir representaciones de instrucciones, datos, sonido e imagen, grabados de forma binaria legible por máquina, y susceptibles de ser manipulados o ser interactivos con el usuario mediante una máquina automática para tratamiento de información
	8524	40	Cintas magnéticas para reproducir fenómenos distintos del sonido o la imagen
	8524	60	Tarjetas con tira magnética incorporada
	8524	91	Soportes para reproducir fenómenos distintos del sonido o la imagen
ex	8524	99	Los demás:
			- para reproducir representaciones de instrucciones, datos, sonido e imagen, grabados de forma binaria legible por máquina, y susceptibles de ser manipulados o ser interactivos con el usuario mediante una máquina automática para tratamiento de información
ex	8525	10	Emisores excepto los aparatos de radiodifusión o televisión
	8525	20	Emisores receptores
ex	8525	40	Videocámaras de imagen fija digitales
ex	8527	90	Receptores de bolsillo para instalaciones de llamada, aviso o búsqueda de personas
ex	8529	10	Antenas del tipo utilizado en aparatos de radiotelefonía y de radiotelegrafía
ex	8529	90	Partes de:
			emisores excepto los aparatos de radiodifusión o televisión emisores receptores videocámaras de imagen fija digitales receptores de bolsillo para instalaciones de llamada, aviso o búsqueda de personas
	8531	20	Tableros indicadores con dispositivos de cristal líquido (LCD) o diodos emisores de luz (LED)
ex	8531	90	Partes de aparatos de la subpartida 8531 20

	S	A	Designación del SA
96			g and the state of
	8532		Condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables
	8532	10	Condensadores fijos para redes eléctricas de 50/60 Hz capaces de absorber una potencia reactiva igual o superior a 0,5 kvar (condensadores de potencia)
	8532	21	Condensadores fijos de tántalo
	8532	22	Condensadores fijos electrolíticos de aluminio
	8532	23	Condensadores fijos con dieléctrico de cerámica de una sola capa
	8532	24	Condensadores fijos con dieléctrico de cerámica, multicapas
	8532	25	Condensadores fijos con dieléctrico de papel o de plástico
	8532	29	Los demás condensadores fijos
	8532	30	Condensadores variables o ajustables
	8532	90	Partes
	8533		Resistencias eléctricas, excepto las de calentamiento (incluidos los reóstatos y potenciómetros)
	8533	10	Resistencias fijas de carbono, aglomeradas o de capa
	8533	21	Las demás resistencias fijas de potencia inferior o igual a 20 W
	8533	29	Las demás resistencias fijas de potencia igual o superior a 20 W
	8533	31	Resistencias variables bobinadas, incluidos los reóstatos y los potenciómetros de potencia inferior o igual a 20 W
	8533	39	Resistencias variables bobinadas, incluidos los reóstatos y los potenciómetros de potencia igual o superior a 20 W
	8533	40	Las demás resistencias variables, incluidos los reóstatos y los potenciómetros
	8533	90	Partes
	8534		Circuitos impresos
ex	8536	50	Conmutadores electrónicos de corriente alterna formados por circuitos de entrada y de salida acoplados ópticamente (conmutadores de corriente alterna con tiristores, aislados)
ex	8536	50	Conmutadores electrónicos, incluidos los conmutadores electrónicos con protección térmica, formados por un transistor y un microcircuito lógico (tecnología híbrida) para una tensión igual o inferior a 1000 voltios
ex	8536	50	Conmutadores con colector electromecánico para una corriente igual o inferior a 11 amperios
ex	8536	69	Clavijas y tomas de corriente para cables coaxiales y circuitos impresos
ex	8536	90	Conexiones y elementos de contacto para hilos y cables
Í	8541		Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados:
	8541	10	Diodos, excepto los fotodiodos y los diodos emisores de luz

	S	A	Designación del SA
96			
	8541	21	Transistores, excepto los fototransistores, con una capacidad de disipación inferior a 1 W
	8541	29	Transistores, excepto los fototransistores, con una capacidad de disipación igual o superior a 1 W
Ī	8541	30	Tiristores, diacs y triacs, excepto los dispositivos fotosensibles
	8541	40	Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz
	8541	50	Los demás dispositivos semiconductores
Ī	8541	60	Cristales piezoeléctricos montados
	8541	90	Partes
	8542		Circuitos integrados y microestructuras electrónicas
Ī	8542	12	Tarjetas provistas de circuitos integrados electrónicos ("tarjetas inteligentes")
	8542	13	Semiconductores de óxido metálico (tecnología MOS)
	8542	14	Circuitos obtenidos por tecnología bipolar
	8542	19	Los demás circuitos integrados monolíticos digitales, incluidos los circuitos obtenidos por combinación de las tecnologías MOS y bipolar (tecnología BIMOS)
	8542	30	Los demás circuitos integrados monolíticos
Ï	8542	40	Circuitos integrados híbridos
	8542	50	Microestructuras electrónicas
İ	8542	90	Partes
	8543	81	Tarjetas y etiquetas de activación por proximidad
ex	8543	89	Máquinas eléctricas con funciones de traducción o de diccionario
ex	8544	41	Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 80 V, con piezas de conexión, del tipo utilizado para las telecomunicaciones
ex	8544	49	Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 80 V, sin piezas de conexión, del tipo utilizado para las telecomunicaciones
ex	8544	51	Los demás conductores eléctricos para una tensión superior a 80 V pero inferior o igual a 1.000 V, con piezas de conexión, del tipo empleado en las telecomunicaciones
İ	8544	70	Cables de fibras ópticas
	9001	10	Fibras ópticas, haces y cables de fibras ópticas
ex	9009	12	Fotocopiadoras electrostáticas digitales, con reproducción del original mediante soporte intermedio (procedimiento indirecto)
ex	9009	21	Las demás fotocopiadoras electrostáticas digitales, ópticas
	9009	90	Partes y accesorios
	9026		Instrumentos y aparatos para la medida o control del caudal, nivel, presión u otras características variables de los líquidos o de los gases (por ejemplo: caudalímetros, indicadores de nivel, manómetros o contadores de calor), con exclusión de los

06	SA	Designación del SA
96		
		instrumentos y aparatos de las partidas 9014, 9015, 9028 o 9032:
	9026 10	Instrumentos para la medida o control del caudal o del nivel de los líquidos
	9026 20	Instrumentos y aparatos para la medida o control de la presión
	9026 80	Los demás instrumentos y aparatos para la medida o control de la partida 9026
	9026 90	Partes y accesorios de instrumentos y aparatos de la partida 9026
	9027 20	Cromatógrafos y aparatos de electroforesis
	9027 30	Espectrómetros, espectrofotómetros y espectrógrafos que utilicen radiaciones ópticas (UV, visibles, IR)
	9027 50	Los demás instrumentos y aparatos que utilicen radiaciones ópticas (UV, visibles, IR) de la partida 9027
	9027 80	Los demás instrumentos y aparatos de la partida 9027 (excepto los de la partida 9027 10)
ex	9027 90	Partes y accesorios de productos de la partida 9027, excepto los analizadores de gases o de humos y los micrótomos
	9030 40	Instrumentos y aparatos para la medida y control, especialmente concebidos para las técnicas de telecomunicación (por ejemplo: hipsómetros, kerdómetros, distorsiómetros o sofómetros)

Apéndice A, sección 2

Equipos para la fabricación y pruebas de semiconductores, y partes de los mismos

Código del SA	Designación de la mercancía	Comentario	s
ex 7017.10	Tubos de reactancia de cuarzo y soportes diseñados para su inserción en hornos de difusión y oxidación para la producción de discos (obleas) semiconductores		e
ex 8419.89	Aparatos de deposición química de vapor para la producción de semiconductores	Para Apéndice B	e
ex 8419.90	Partes de los aparatos de deposición química de vapor para la producción de semiconductores	Para Apéndice B	e
ex 8421.19	Secadoras centrífugas para la elaboración de discos (obleas) semiconductores		
ex 8421.91	Partes de las secadoras centrífugas para la elaboración de discos (obleas) semiconductores		
ex 8424.89	Máquinas de rebabar para limpiar y eliminar los contaminantes de los hilos metálicos de salida de las estructuras de semiconductores antes del proceso de galvanoplastia		
ex 8424.89	Pulverizadores para atacar químicamente, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores		
ex 8424.90	Partes de los pulverizadores para atacar químicamente, desnudar o		

	Código del SA	Designación de la mercancía	Comentario	os
		limpiar los discos (obleas) semiconductores		
ex	8456.10	Máquinas que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o de fotones en la producción de discos (obleas) semiconductores		
ex	8456.91	Aparatos para atacar en seco, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores	Para Apéndice B	e
	8456.91	Máquinas para grabar en seco la traza sobre material semiconductor		
ex	8456.99	Fresadoras de haces iónicos focalizados para la producción o reparación de máscaras y retículos utilizados como modelos en los discos (obleas) semiconductores		
ex	8456.99	Cortadoras por haz de láser para cortar las pistas de contacto en la producción de semiconductores	Para Apéndice B	e.
ex	8464.10	Máquinas para cortar en rodajas los lingotes monocristalinos o los discos (obleas) en microplaquitas	Para Apéndice B	e
ex	8464.20	Máquinas de amolar, pulir y rodar para la elaboración de discos (obleas) semiconductores		
ex	8464.90	Máquinas de fragmentación para marcar o ranurar los discos (obleas) semiconductores		
ex	8466.91	Partes de las máquinas para cortar en rodajas los lingotes monocristalinos o los discos (obleas) en microplaquitas	Para Apéndice B	e.
ex	8466.91	Partes de las máquinas de fragmentación para marcar o ranurar los discos (obleas) semiconductores	Para Apéndice B	e
ex	8466.91	Partes de las máquinas de amolar, pulir y rodar para la elaboración de discos (obleas) semiconductores		

-			_	
ex	8466.93	Partes de las fresadoras de haces iónicos focalizados para la producción o reparación de máscaras y retículos utilizados como modelos en los discos (obleas) semiconductores		
ex	8466.93	Partes de las cortadoras por haz de láser para cortar las pistas de contacto en la producción de semiconductores mediante láser	Para Apéndice B	e!
ex	8466.93	Partes de las máquinas que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o de fotones en la producción de discos (obleas) semiconductores		
ex	8466.93	Partes de los aparatos para atacar en seco, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores	Para Apéndice B	e!
ex	8466.93	Partes de la máquinas para grabar en seco la traza sobre material semiconductor		
ex	8477.10	Equipos de encapsulación para el montaje de semiconductores	Para Apéndice B	e.
ex	8477.90	Partes de los equipos de encapsulación	Para Apéndice B	e!
ex	8479.50	Máquinas automatizadas para el transporte, la manipulación y el almacenamiento de discos (obleas) semiconductores, casetes de discos (obleas), cajas de discos (obleas) y demás material para dispositivos semiconductores		e
ex	8479.89	Aparatos para el crecimiento y estiramiento de los lingotes semiconductores monocristalinos		
ex	8479.89	Aparatos para la deposición física por pulverización en discos (obleas) semiconductores	Para Apéndice B	e
ex	8479.89	Aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y los visualizadores de panel plano	Para Apéndice B	e!
ex	8479.89	Aparatos de fijación por matriz, soldadores automáticos de cintas y soldadores de hilos para el montaje de semiconductores	Para Apéndice B	e!
ex	8479.89	Equipos de encapsulación para el montaje de semiconductores	Para Apéndice B	e!
ex	8479.89	Máquinas de deposición epitaxial para los discos (obleas) semiconductores		
ex	8479.89	Máquinas para enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar los hilos de salida de los semiconductores	Para Apéndice B	e!
ex	8479.89	Aparatos de deposición física para la producción de semiconductores	Para Apéndice B	e!
ex	8479.89	Rotores para revestir con emulsiones fotográficas los discos (obleas) semiconductores	Para Apéndice B	e
ex	8479.90	Partes de los aparatos para la deposición física por pulverización en discos (obleas) semiconductores	Para Apéndice B	e
ex	8479.90	Partes de los aparatos de fijación por matriz, soldadores automáticos de cintas y soldadores de hilos para el montaje de semiconductores	Para Apéndice B	e
ex	8479.90	Partes de rotores para revestir con emulsiones fotográficas los discos	Para	e

(obleas) semiconductores Apéndice B

ex 8479.90 Partes de los aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y los visualizadores de panel plano de discos (obleas) y el almacenamiento de los discos (obleas) de semiconductores y el almacenamiento de los discos (obleas) y demás material para dispositivos semiconductores ex 8479.90 Partes de los equipos de encapsulación para el montaje de semiconductores ex 8479.90 Partes de los equipos de encapsulación para el montaje de semiconductores ex 8479.90 Partes de los máquinas para enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar los hilos de salida de los semiconductores ex 8479.90 Partes de los aparatos de deposición física para la producción de dispositivos semiconductores ex 8479.90 Partes de los aparatos de deposición física para la producción de dispositivos semiconductores ex 8480.71 Moldes por inyección o por compresión para la fabricación de dispositivos semiconductores ex 8514.10 Homos de resistencia (de caldeo indirecto) para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.20 Homos que trabajen por inducción o por pérdidas dieléctricas para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.30 Aparatos para el calentamiento rápido de discos (obleas) semiconductores ex 8514.90 Partes de aparatos para el calentamiento rápido de discos (obleas) Para Apéndice B ex 8514.90 Partes de homos de las partidas Nº 8514 10 a 8514 30 Sondas de discos (obleas) semiconductores ex 8534.30 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90	ex	8479.90	Partes de los aparatos para el crecimiento y estiramiento de los lingotes semiconductores monocristalinos	
y el almacenamiento de los discos (obleas) de semiconductores, las casetes de discos (obleas), las cajas de discos (obleas) y demás material para dispositivos semiconductores ex 8479.90 Partes de los equipos de encapsulación para el montaje de semiconductores ex 8479.90 Partes de las máquinas para enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar Para los hilos de salida de los semiconductores ex 8479.90 Partes de las máquinas para enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar Para Apéndice B ex 8479.90 Partes de los aparatos de deposición física para la producción de semiconductores ex 8479.90 Partes de los aparatos de deposición física para la producción de desemiconductores ex 8480.71 Moldes por inyección o por compresión para la fabricación de dispositivos semiconductores ex 8514.10 Hornos que trabajen por inducción o por perdidas dieléctricas para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.20 Hornos que trabajen por inducción o por perdidas dieléctricas para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) ex 8514.30 Aparatos para el calentamiento rápido de discos (obleas) Para semiconductores ex 8514.30 Partes de hornos de resistencia (de caldeo indirecto) para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.90 Partes de hornos de las partidas Nºa 8514 10 a 8514 30 ex 8536.90 Sondas de discos (obleas) semiconductore ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de	ex	8479.90		e.
semiconductores 8479.90 Partes de las máquinas para enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar los hilos de salida de los semiconductores ex 8479.90 Partes de las máquinas para enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar los hilos de salida de los semiconductores ex 8479.90 Partes de los aparatos de deposición física para la producción de semiconductores ex 8480.71 Moldes por inyección o por compresión para la fabricación de dispositivos semiconductores ex 8514.10 Hornos de resistencia (de caldeo indirecto) para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.20 Hornos que trabajen por inducción o por pérdidas dieléctricas para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.30 Aparatos para el calentamiento rápido de discos (obleas) semiconductores ex 8514.30 Partes de hornos de resistencia (de caldeo indirecto) para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.90 Partes de hornos de resistencia (de caldeo indirecto) para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.90 Partes de hornos de las partidas Nºº 8514 10 a 8514 30 ex 8536.90 Sondas de discos (obleas) semiconductores 8543.11 Aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor 9010.41 Aparatos para proyectar, realizar la traza o recubrir circuitos sobre material semiconductor sensibilizado y visualizadores de panel plano	ex	8479.90	y el almacenamiento de los discos (obleas) de semiconductores, las casetes de discos (obleas), las cajas de discos (obleas) y demás material	e
semiconductores ex 8479.90 Partes de las máquinas para enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar Apéndice B ex 8479.90 Partes de los aparatos de deposición física para la producción de semiconductores ex 8480.71 Moldes por inyección o por compresión para la fabricación de dispositivos semiconductores ex 8514.10 Hornos de resistencia (de caldeo indirecto) para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.20 Hornos que trabajen por inducción o por perdidas dieléctricas para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.30 Aparatos para el calentamiento rápido de discos (obleas) semiconductores ex 8514.30 Partes de hornos de resistencia (de caldeo indirecto) para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.30 Partes de hornos de resistencia (de caldeo indirecto) para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.90 Partes de hornos de resistencia (de caldeo indirecto) para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.90 Partes de aparatos para el calentamiento rápido de discos (obleas) Para Apéndice B ex 8514.90 Partes de hornos de las partidas Nosses 8514 10 a 8514 30 ex 8536.90 Sondas de discos (obleas) semiconductores 8543.11 Aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor 9010.41 Aparatos para proyectar, real	ex	8479.90		e
los hilos de salida de los semiconductores ex 8479.90 Partes de los aparatos de deposición física para la producción de semiconductores ex 8480.71 Moldes por inyección o por compresión para la fabricación de dispositivos semiconductores ex 8514.10 Hornos de resistencia (de caldeo indirecto) para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.20 Hornos que trabajen por inducción o por pérdidas dieléctricas para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.30 Aparatos para el calentamiento rápido de discos (obleas) semiconductores ex 8514.30 Partes de hornos de resistencia (de caldeo indirecto) para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.90 Partes de aparatos para el calentamiento rápido de discos (obleas) ex 8514.90 Partes de aparatos para el calentamiento rápido de discos (obleas) ex 8536.90 Sondas de discos (obleas) semiconductores ex 8543.11 Aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor 9010.41 Aparatos para proyectar, realizar la traza o recubrir circuitos sobre material semiconductor sensibilizado y visualizadores de panel plano	ex	8479.90		
semiconductores ex 8480.71 Moldes por inyección o por compresión para la fabricación de dispositivos semiconductores ex 8514.10 Hornos de resistencia (de caldeo indirecto) para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.20 Hornos que trabajen por inducción o por pérdidas dieléctricas para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.30 Aparatos para el calentamiento rápido de discos (obleas) semiconductores ex 8514.30 Partes de hornos de resistencia (de caldeo indirecto) para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.90 Partes de aparatos para el calentamiento rápido de discos (obleas) ex 8514.90 Partes de aparatos para el calentamiento rápido de discos (obleas) Para Apéndice B ex 8514.90 Partes de hornos de las partidas Nº8 8514 10 a 8514 30 ex 8536.90 Sondas de discos (obleas) semiconductores ex 8543.11 Aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor semiconductor semiconduc	ex	8479.90		e
dispositivos semiconductores ex 8514.10 Hornos de resistencia (de caldeo indirecto) para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.20 Hornos que trabajen por inducción o por pérdidas dieléctricas para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.30 Aparatos para el calentamiento rápido de discos (obleas) Para Apéndice B ex 8514.30 Partes de hornos de resistencia (de caldeo indirecto) para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.90 Partes de aparatos para el calentamiento rápido de discos (obleas) ex 8514.90 Partes de hornos de las partidas Nºs 8514 10 a 8514 30 ex 8536.90 Sondas de discos (obleas) semiconductores ex 8543.11 Aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor ex 8543.30 Aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor 9010.41 Aparatos para proyectar, realizar la traza o recubrir circuitos sobre material semiconductor sensibilizado y visualizadores de panel plano	ex	8479.90		e
dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.20 Hornos que trabajen por inducción o por pérdidas dieléctricas para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.30 Aparatos para el calentamiento rápido de discos (obleas) Para Apéndice B ex 8514.30 Partes de hornos de resistencia (de caldeo indirecto) para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.90 Partes de aparatos para el calentamiento rápido de discos (obleas) Para Apéndice B ex 8514.90 Partes de hornos de las partidas N° 8514 10 a 8514 30 Sondas de discos (obleas) semiconductores ex 8536.90 Aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor ex 8543.30 Aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano Apéndice B ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano Apéndice B ex 8543.90 Partes de aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor 9010.41 Aparatos para proyectar, realizar la traza o recubrir circuitos sobre material semiconductor sensibilizado y visualizadores de panel plano	ex	8480.71		
fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.30 Aparatos para el calentamiento rápido de discos (obleas) Para Apéndice B ex 8514.30 Partes de hornos de resistencia (de caldeo indirecto) para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.90 Partes de aparatos para el calentamiento rápido de discos (obleas) ex 8514.90 Partes de hornos de las partidas Nºs 8514 10 a 8514 30 ex 8536.90 Sondas de discos (obleas) semiconductores ex 8543.11 Aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor ex 8543.30 Aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor ex 8543.90 Partes de aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor 9010.41 Aparatos para proyectar, realizar la traza o recubrir circuitos sobre material semiconductor sensibilizado y visualizadores de panel plano	ex	8514.10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
semiconductores ex 8514.30 Partes de hornos de resistencia (de caldeo indirecto) para la fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.90 Partes de aparatos para el calentamiento rápido de discos (obleas) ex 8536.90 Partes de hornos de las partidas N° 8514 10 a 8514 30 ex 8536.90 Sondas de discos (obleas) semiconductores ex 8543.11 Aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor ex 8543.30 Aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor 9010.41 Aparatos para proyectar, realizar la traza o recubrir circuitos sobre material semiconductor sensibilizado y visualizadores de panel plano	ex	8514.20	fabricación de dispositivos semiconductores en discos (obleas)	
de dispositivos semiconductores en discos (obleas) semiconductores ex 8514.90 Partes de aparatos para el calentamiento rápido de discos (obleas) ex 8514.90 Partes de hornos de las partidas N° 8514 10 a 8514 30 ex 8536.90 Sondas de discos (obleas) semiconductores ex 8543.11 Aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor ex 8543.30 Aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor 9010.41 Aparatos para proyectar, realizar la traza o recubrir circuitos sobre material semiconductor sensibilizado y visualizadores de panel plano	ex	8514.30		e
ex 8514.90 Partes de hornos de las partidas N ^{os} 8514 10 a 8514 30 ex 8536.90 Sondas de discos (obleas) semiconductores 8543.11 Aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor ex 8543.30 Aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los Apéndice B ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor 9010.41 Aparatos para proyectar, realizar la traza o recubrir circuitos sobre material semiconductor sensibilizado y visualizadores de panel plano	ex	8514.30		
ex 8536.90 Sondas de discos (obleas) semiconductores 8543.11 Aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor ex 8543.30 Aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor 9010.41 Aparatos para proyectar, realizar la traza o recubrir circuitos sobre material semiconductor sensibilizado y visualizadores de panel plano	ex	8514.90	Partes de aparatos para el calentamiento rápido de discos (obleas)	 e
Apéndice B 8543.11 Aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor ex 8543.30 Aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor 9010.41 Aparatos para proyectar, realizar la traza o recubrir circuitos sobre material semiconductor sensibilizado y visualizadores de panel plano	ex	8514.90	Partes de hornos de las partidas N°s 8514 10 a 8514 30	
ex 8543.30 Aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los Apéndice B ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor 9010.41 Aparatos para proyectar, realizar la traza o recubrir circuitos sobre material semiconductor sensibilizado y visualizadores de panel plano	ex	8536.90	Sondas de discos (obleas) semiconductores	e
(obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano Apéndice B ex 8543.90 Partes de aparatos para atacar con ácido, revelar, desnudar o limpiar los discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano ex 8543.90 Partes de aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor 9010.41 Aparatos para proyectar, realizar la traza o recubrir circuitos sobre material semiconductor sensibilizado y visualizadores de panel plano		8543.11	Aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor	
discos (obleas) semiconductores y visualizadores de panel plano Apéndice B ex 8543.90 Partes de aparatos de implantación iónica para dopar material semiconductor 9010.41 Aparatos para proyectar, realizar la traza o recubrir circuitos sobre material semiconductor sensibilizado y visualizadores de panel plano	ex	8543.30		e
semiconductor 9010.41 Aparatos para proyectar, realizar la traza o recubrir circuitos sobre material semiconductor sensibilizado y visualizadores de panel plano	ex	8543.90		e
a material semiconductor sensibilizado y visualizadores de panel plano	ex	8543.90		
		a		
ex 9010.90 Partes y accesorios de los aparatos de las partidas № 9010 41 a 9010 49	ex		Partes y accesorios de los aparatos de las partidas Nº 9010 41 a 9010 49	

ex	9011.10	Microscopios estereoscópicos ópticos dotados de equipo diseñado específicamente para la manipulación y transporte de discos (obleas) semiconductores o retículos		e.
ex	9011.20	Microscopios fotomicrográficos dotados de equipo diseñado específicamente para la manipulación y transporte de discos (obleas) semiconductores o retículos		e.
ex	9011.90	Partes y accesorios de microscopios estereoscópicos dotados de equipo diseñado específicamente para la manipulación y transporte de discos (obleas) semiconductores o retículos		
ex	9011.90	Partes y accesorios de microscopios fotomicrográficos dotados de equipo diseñado específicamente para la manipulación y transporte de discos (obleas) semiconductores o retículos		e.
ex	9012.10	Microscopios de haz electrónico dotados con equipo específicamente diseñado para la manipulación y transporte de discos (obleas) semiconductores o retículos		e
ex	9012.90	Partes y accesorios de microscopios de haz electrónico dotados con equipo diseñado específicamente para la manipulación y transporte de discos (obleas) semiconductores o retículos		e
ex	9017.20	Aparatos generadores de modelos para la producción de máscaras y retículos a partir de sustratos revestidos de una capa fotorresistente	Para Apéndice B	e
ex	9017.90	Partes y accesorios para aparatos generadores de modelos para la producción de máscaras y retículos a partir de sustratos revestidos de una capa fotorresistente		e
ex	9017.90	Partes de esos aparatos generadores de modelos	Para Apéndice B	e.
	9030.82	Instrumentos y aparatos para la medida o detección de plaquitas "wafers" o mecanismos semiconductores		
ex	9030.90	Partes y accesorios de instrumentos y aparatos para la medida o control de plaquitas "wafers" o mecanismos semiconductores		
ex	9030.90	Partes de instrumentos y aparatos para la medida o control de plaquitas "wafers" o dispositivos semiconductores		
	9031.41	Instrumentos y aparatos ópticos para el control de las plaquitas ("wafers") o dispositivos semiconductores, o para el control de las máscaras y retículas utilizadas en la fabricación de dispositivos semiconductores		
ex	9031.49	Instrumentos y aparatos ópticos para la medición de las impurezas de material particulado en la superficie de los discos (obleas) semiconductores		
ex	9031.90	Partes y accesorios de instrumentos y aparatos ópticos para el control de las plaquitas ("wafers") o dispositivos semiconductores, o para el control de las máscaras, fotomáscaras y retículas utilizadas en la fabricación de dispositivos semiconductores		
ex	9031.90	Partes y accesorios de instrumentos ópticos para la medición de las impurezas de material particulado en la superficie de los discos (obleas) semiconductores		

Apéndice B

Lista positiva de los productos específicos que quedarán comprendidos en el ámbito del presente Acuerdo cualquiera que sea la partida del SA en que estén clasificados.

Cuando se especifiquen partes, éstas quedarán comprendidas con arreglo a la nota 2 b) de la sección XVI y las notas del capítulo 90 del SA, respectivamente.

Ordenadores (computadores): Máquinas automáticas para tratamiento de información capaces de 1) registrar el programa o los programas de proceso y, por lo menos, los datos inmediatamente necesarios para la ejecución de ese o de esos programas; 2) programarse libremente por el usuario de acuerdo con sus necesidades; 3) realizar cálculos aritméticos definidos por el usuario; y 4) realizar, sin intervención humana, un programa de proceso en el que puedan, por decisión lógica, modificar la ejecución durante el tratamiento.

El Acuerdo abarca las máquinas automáticas para tratamiento de información que sean capaces o no de recibir y procesar con la asistencia de una unidad central de proceso señales de telefonía, señales de televisión u otras señales sonoras o visuales analógica o digitalmente procesadas. No están comprendidas en el presente Acuerdo las máquinas que realicen una función propia distinta del tratamiento de información, o incorporen una máquina automática para tratamiento de información o trabajen en relación con tal máquina, que no estén especificadas de otro modo en la parte A o en la parte B.

Amplificadores eléctricos utilizados como repetidores en los productos de línea telefónica comprendidos en el presente Acuerdo, y partes de los mismos.

Visualizadores de panel plano (incluidos los de cristal líquido (LDC), electroluminiscentes, los de plasma y demás tecnologías) para productos comprendidos en el presente Acuerdo, y partes de los mismos.

Equipo de red: aparatos para Red de Área Local (LAN) y Red de Área Extensa (WAN), incluidos los productos utilizados exclusiva o principalmente para permitir la interconexión de máquinas automáticas para tratamiento de información y las unidades de las mismas para formar una red utilizada primordialmente para compartir recursos tales como unidades centrales de proceso, dispositivos de almacenamiento de datos y unidades de entrada y salida incluidos los adaptadores, múltiples de impulsos (hubs), repetidores en línea, convertidores, concentradores, puentes y direccionadores y conjuntos de circuitos impresos para incorporación física en máquinas automáticas para tratamiento de información o unidades de las mismas.

Pantallas de control: unidades de visualización de máquinas automáticas para tratamiento de información con tubo de rayos catódicos con trama de puntos de separación inferior a 0,4 mm, que no pueden recibir ni procesar señales de televisión ni otras señales sonoras o visuales procesadas analógica o digitalmente sin la asistencia de la unidad central de proceso de un ordenador según se define en el presente Acuerdo.

Por consiguiente no están comprendidas en el ámbito del Acuerdo las televisiones (ni aun las de alta definición).³

Unidades de memoria de disco óptico para máquinas automáticas para tratamiento de información (incluidas las unidades CD y DVD), puedan o no escribir/registrar además de leer, inclusive en sus

³Los participantes examinarán la designación de este producto en enero de 1999 en el marco de las disposiciones sobre consulta del párrafo 3 del Anexo.

envolturas.

Dispositivos de alerta de radiomensajes, y sus partes.

Trazadores, sean unidades de entrada o de salida de la partida Nº 8471 del SA o máquinas de dibujo o trazado de la partida Nº 9017 del SA.

Estructuras de circuitos impresos para los productos comprendidos en el presente Acuerdo, incluidas las estructuras de esa clase para conexiones externas, como las tarjetas que cumplen la norma PCMCIA.

Esas estructuras de circuitos impresos constan de uno o más circuitos impresos de la partida Nº 8534 con uno o más elementos activos montados en ellos, con o sin elementos pasivos. "Elementos activos" significa diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares, sean o no fotosensibles, de la partida Nº 8541, y circuitos integrados y microestructuras de la partida Nº 8542.

Unidades visualizadoras de panel plano para proyección utilizadas con las máquinas automáticas para tratamiento de información, capaces de visualizar información numérica generada por la unidad central de proceso.

Dispositivos patentados de memoria de formatos, incluidos los medios para los mismos, para máquinas automáticas para tratamiento de información, con o sin medios desmontables y sean de tecnología magnética, óptica u otra, incluidas las unidades de memoria de cartucho Bernoulli Box, Syquest o Zipdrive.

Equipos de perfeccionamiento multimedia para máquinas automáticas para tratamiento de información y unidades de los mismos, acondicionados para la venta al por menor y que consten de, al menos, altavoces y/o micrófonos además de una estructura de circuito integrado que permita a las máquinas automáticas para tratamiento de información y a las unidades de las mismas procesar señales sonoras (tarjetas de sonido).

Adaptadores multimedia que desempeñan una función de comunicación: dispositivo de microprocesador, que incorpora un módem para acceso a Internet y que tiene una función de intercambio de información interactivo.